

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	中泰证券、广发基金、和谐汇一、信泰人寿、国投证券、中信建投、地泽投资、杭州深沃投资管理合伙企业（有限合伙）、德邦证券、融通基金、广发证券、富国基金、长信基金、国泰基金、中邮证券、华商基金、嘉实基金、国寿资管、泰康资管、华夏基金、平安基金、华创证券、国盛证券、博时基金、国寿养老、浦银安盛、南方基金、中信保诚、长城基金、华富基金、财通资管、国元证券、国海证券、中金公司、诚旻投资、泓德基金、Fidelity Funds 共 37 家机构。
时间	2024 年 10 月 24 日-2024 年 12 月 13 日
地点	现场交流、公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李妍君
交流内容及具体问答记录	一、公司概况 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工

具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。

二、问答环节

1、请公司对 2024 年三季度经营业绩做简要介绍？

2024 年 1-9 月，公司实现销售收入 28,732.15 万元，同比增长 12.22%，主要增量来自于软件产品收入的快速增长。2024 年 1-9 月，归属于上市公司股东的净利润 770.97 万元，同比有所下滑，主要系公司研发投入 20,117.60 万元，同比增长 37.72%。高强度的研发投入对公司的短期业绩会形成一定的压力，但从长远发展的角度，研发投入是提升公司核心竞争力的源泉。未来公司仍将围绕集成电路成品率提升领域开展研发及经营活动，完善软硬件产品布局。

2、AI 和大模型是当前技术领域热点，请问公司是否有在该领域的技术布局？

AI 技术正被应用在芯片的研发和制造中，在设计阶段，AI 可以通过机器学习算法，提高芯片性能和能效；在制造过程中，AI 用于预测和检测缺陷，优化生产流程，快速提升良率；同时 AI 模型可以分析海量制造数据，找出潜在问题并进行预防性维护。

公司自 2022 年开始已经将 AI 技术应用于公司的半导体大数据分析与管理系统，并在持续深入应用中，今年上半年公司半导体人工智能应用平台 INF-AI 正式发布，且已被多家客户引入使用。未来，公司将持续拥抱计算机的技术革新，探索 AI 和大模型等技术应用到流程设计、模型调参等场景，以不断提升 EDA 软件的产品性能和设计效率。

3、公司新发布的 DE-YMS2.0 具体有哪些功能提升？

自广立微推出良率管理系统（DE-YMS）以来，已在超过百家设计公司、晶圆厂及封测厂中得到广泛验证和不断完善。近日，广立微正式发布 DE-YMS 2.0 版本，通过全面整合半导体全流程

数据，新增了多 Die 合封数据分析、Fail Bit Map (FBM) 分析等多个模块，解决了多 Die 合封数据分析、物料回溯等关键技术难题。

1) 全流程数据采集：支持从芯片设计、制造、封装到测试的全流程数据采集与分析，采用微服务架构与分布式数据库，数据统计、查询性能提升 1.5~5 倍。

2) 良率分析场景：DE-YMS 2.0 提供了包括相关性、共同性、区域性等多种分析方法，灵活的数据关联和过滤功能，通过一键式操作，快速定位良率瓶颈，效率提升达到十倍。

3) 多 Die 合封数据分析：新增的多 Die 合封分析模块对 FT 数据进行全链条追溯，提供 Strip 维度或 wafer 维度的全面数据展示，通过多个 Die 数据对比分析，精准锁定良率问题根源，助力提高封装技术的生产效率。

4) FBM (Fail Bit Map) 分析模块：为存储器芯片失效分析提供精准支持，帮助设计与制造团队识别失效模式，支持存储产品与 SOC 产品存储模块失效分析，进行多维度失效类型统计与分析，优化工艺设计，提高良率。

5) 全流程数据回溯：DE-YMS 2.0 加强了全流程数据回溯能力。RMA (Return Material Authorization) 模块能够串联芯片的全周期数据，全面追踪失效芯片的生产履历，帮助工程师快速识别生产问题源，优化流程管理，提高生产效率与产品质量。

6) 车规标准 Ink Master：DE-YMS 2.0 内置的 INK Master 模块支持车规级标准，帮助工程师高效管理和监控芯片质量，确保产品在高可靠性和严苛环境下的稳定性，特别适用于车载电子等对质量要求极高的领域。

4、近期出台较多支持鼓励并购重组的政策，请问公司是否有并购计划？

上市公司并购是一种加快企业做大做强的重要手段，EDA 行业具有产品链长、工具品类繁多、技术门槛高等特点，纵观国

	<p>际 EDA 龙头企业的发展史均是频繁的并购史，通过并购加快产品矩阵布局、整合提升企业的竞争力，成长壮大并发展成为业界顶尖企业。</p> <p>公司将借鉴 EDA 产业界的成功经验，根据企业的总体战略规划，立足自身稳健发展的同时，积极关注与公司业务相关领域的发展情况，综合考虑内外部的多方面因素，合理运用资本工具加速公司成长和发展，助力公司不断提升综合实力和市场竞争能力。同时，公司也将严格遵守相关法律法规的要求，当出现上述重大事项时及时向广大投资者披露。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2024 年 12 月 13 日